

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临2025-026

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日上午11:00-12:00通过价值在线路演中心（网址：<https://www.ir-online.cn/>）以网络文字互动的方式召开了2025年半年度业绩说明会，针对公司2025年半年度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2025年8月29日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2025-025），并向广大投资者征集大家所关心的问题。

公司于2025年9月5日上午11:00-12:00，通过价值在线路演中心（网址：<https://www.ir-online.cn/>）以网络文字互动的方式召开了2025年半年度业绩说明会。公司董事长兼总经理王蔚先生、董事会秘书兼财务总监段佳国先生、独立董事刘海燕女士出席了本次说明会，针对公司2025年半年度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题1：你好，作为公司股东留意到公司业务方面扩展进度比较慢，导致公司营收和利润增速没有像同类公司那样高，想问一下1.关于visic公司的氮化镓业

务是否达到了国产化的条件？2.海外马来西亚的生产进度如何，未来是什么定位规划？3.对于国内的ai芯片封装贵公司是否有技术储备？4.大股东和公司高管都接连减持，是否不看好公司未来发展？

回答：1、随着汽车智能化的快速发展，单车摄像头搭载数量和价值量不断提升，驱动车规 CIS 芯片市场需求呈现显著增长趋势，公司作为全球车规摄像头芯片晶圆级 TSV 封装技术的领先者，在车规 CIS 领域的封装业务规模与技术领先优势持续提升。同时，随着 AI 眼镜、机器人等新兴应用领域的持续发展，带动视觉传感器市场需求的快速增长。受益于此，公司的业务规模与盈利能力呈现快速增长态势，2025 年上半年实现销售收入 6.67 亿元，同比增长 24.68%，实现归属上市公司净利润 1.65 亿元，同比增长 49.78%，实现归属上市公司扣非净利润 1.51 亿元，同比增长 67.28%。

2、公司投资的以色列 VisIC 公司为全球领先的第三代半导体 GaN（氮化镓）器件设计公司，正在积极开发基于硅基氮化镓技术的 400V/800V 汽车逆变器方案，其 D3GAN 技术具有导通电阻低，开关频率高，损耗小，可靠性高等特点，并正在和多家知名汽车厂家或 TIE 1 厂商进行芯片及模块设计的合作，全力推进相关产品的规模化应用。

3、为应当前国际贸易与产业重构发展趋势，公司主动求变，积极推进公司市场拓展、技术研发及全球化生产与投资布局，一方面依托新加坡子公司平台，对海外子公司及项目投资架构进行规划调整，有效搭建国际化的投融资平台；另一方面积极推进在马来西亚槟城的生产基地建设，以更好贴近海外客户需求，推进工艺创新与项目开发，保持行业持续领先地位。目前马来西亚槟城生产基地已完成土地厂房的购买事宜，正在推进无尘室的设计与建设工作。

4、随着 AI 技术的快速发展，AI 芯片、自动驾驶、AI 手机等应用场景呈现快速增长趋势，对先进封装技术的创新与服务能力不断提出新的需求。AI 芯片包含大量的计算核心，需要封装技术在有限空间提供高密度互联方案，如通过 TSV 硅通孔技术实现芯片的堆叠、光电共封、光电互联等。公司作为晶圆级 TSV 封装技术的引领者，一直在密切关注产业动态与市场需求，积极推进技术能力的创新开发与项目拓展。

5、目前公司在任高管不存在减持股份情形。股东减持行为系基于其自身情

况及资金需求所作出的安排，与公司的生产经营无关，也不会对公司的生产经营产生影响。

问题 2： 请问一下贵司在马来西亚的工厂进度如何了，什么时候可以量产了？

回答： 马来西亚槟城生产基地已完成土地厂房的购买事宜，正在积极推进无尘室的设计与建设工作，预计 2026 年下半年开始打样、试生产。

问题 3： 公司技术先进，效益也不错，为啥市值这么少？

回答： 公司专注于集成电路先进封装技术服务，聚焦于智能传感器芯片市场应用，在晶圆级TSV先进封装技术领域，公司在技术、生产、市场、客户等方面具有显著的领先优势。公司将高度重视市值管理工作，有效推进市值规模与经营情况的匹配度与相互促进。

问题4： 公司第一大股东中新苏州创业投资公司每年都减持股份，为什么不找一个好买家一次性都转让了？

回答： 股东减持是其根据自身经营与资金需求而做出的计划，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

问题5： 公司控股的以色列公司是否有地域和政治上的风险？对该公司的先进技术是否已经能吸收并加以发展？

回答： 公司投资的以色列VisIC公司为全球领先的第三代半导体 GaN（氮化镓）器件设计公司，正积极与国际知名汽车厂商合作，共同开发车用主驱动逆变器模块，为新型电动汽车提供更高转换效率，更小模块体积和更高可靠性的功率器件产品。公司一直高度关注全球地域与政治发展动态，目前VisIC公司经营正常。

问题6： 王董，您好。请问公司的资本支出与折旧摊销比率从77.6%大幅提升至571.2%，显示出极其强烈的扩张意愿，基于什么考虑？

回答： 为应当前国际贸易与产业重构发展趋势，公司主动求变，积极推进公司市场拓展、技术研发及全球化生产与投资布局，一方面依托新加坡子公司平台，对海外子公司及项目投资架构进行规划调整，有效搭建国际化的投融资平台；另一方面积极推进在马来西亚槟城的生产基地建设，以更好贴近海外客户需求，推进工艺创新与项目开发，保持行业持续领先地位。目前马来西亚槟城生产基地已

完成土地厂房的购买事宜，正在推进无尘室的设计与建设工作，使得公司的资本开支呈现显著提升趋势。

问题7：中新创投这次减持设置了目标价格，公司认为能到这个目标价吗？

回答：关于股东减持情况请见前述相关回复，感谢您对公司的关注。

问题8：结合上半年经营情况和行业趋势，请问公司对全年营收和净利润的预期目标是多少？以及下半年将会重点推进哪些工作？

回答：1、随着智能汽车、AI 眼镜、机器人视觉等应用领域的快速发展，公司所专注的智能传感器市场将持续呈现快速发展态势，据 Yole 数据预测，预计到 2029 年，全球图像传感器（CIS）市场规模将持续增长至 286 亿美元，2023 年至 2029 年复合增长率为 4.7%。公司将通过技术的持续迭代创新、全球研发与生产基地的建设布局，不断提升公司在技术、产能、市场及产业链的竞争能力。2、持续推进 Cavity-Last、TSV-LAST 等技术工艺的开发拓展，进一步提升 MEMS、FILTER 等新领域的量产服务能力，有效拓展 TSV 封装技术的市场应用。3、随着AI、算力与数据中心的快速发展，晶圆级TSV封装技术将在产业中扮演日益重要角色，公司作为晶圆级TSV封装技术的引领者，一直在密切关注AI产业的动态与新市场需求，积极推进技术能力在相关领域的创新开发与项目拓展。

问题9：王董，国内六家封测企业在2025上半年的增速表现也呈现出多元化特征。晶方科技以27.9%的增长率领跑行业，显示出其特色工艺路线的竞争优势。未来是否仍能保持这一势头？

回答：公司专注于集成电路先进封装技术服务，为全球领先的智能传感器先进封装技术开发商与服务商。在晶圆级TSV先进封装技术领域，公司拥有技术、生产、市场、客户等方面显著的领先优势，建立了完整的8英寸和12英寸封装量产线，拥有全球化的生产制造与研发中心布局，积极服务于全球一线芯片设计公司与终端品牌客户。

问题10：你好，王总，目前公司客户出了豪威集团，索尼等，特斯拉是否也是晶方的客户，是否有为特斯拉FSD自动驾驶提供摄像头封测？

回答：公司专注于集成电路先进封装技术服务，为全球领先的智能传感器先进封装技术开发商与服务商，服务于全球一线芯片设计公司与知名终端品牌客户。

问题11：贵公司的业绩持续稳定，股价表现上却弱于预期和同行业，请问在经营上有没有潜在的问题，请及时披露？

回答：公司生产经营情况正常，业务规模与盈利能力呈现显著增长趋势，没有应披露而未披露的事项，感谢您对公司的关注！

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容，详见价值在线路演中心（网址：www.sse.com.cn）。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2025年9月6日